

海通证券股份有限公司关于气派科技股份有限公司

2024 年半年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：海通证券股份有限公司	被保荐公司简称：气派科技
保荐代表人姓名：薛阳、徐扬	被保荐公司代码：688216

重大事项提示

2024 年 1-6 月，以消费电子为代表的下游行业需求有所提升，公司营业收入同比增长 26.61%，但受到产业周期性波动的影响产品价格下跌后尚未完全恢复，叠加公司固定资产折旧金额较大，2024 年上半年公司归属于上市公司股东的净利润-4,059.57 万元，较上年同期亏损减少 2,883.35 万元，亏损幅度有所收窄，但仍处于亏损状态，且公司仍然存在未来因行业持续低迷或经营不当等原因导致净利润持续为负的风险。

2024 年 1-6 月，公司生产经营正常，不存在其他重大风险。

经中国证券监督管理委员会《关于同意气派科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1714 号）批复，气派科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票 26,570,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 14.82 元，募集资金总额为人民币 39,376.74 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 33,822.46 万元。本次发行证券已于 2021 年 6 月 23 日在上海证券交易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“海通证券”）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2023 年 7 月 13 日至 2024 年 12 月 31 日。

在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日持续督导期内（以下简称“本持续督导期间”），保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“上市

规则”)等相关规定,通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式进行持续督导,现就2024年半年度持续督导情况报告如下:

一、2024年半年度保荐机构持续督导工作情况

项目	工作内容
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度,针对公司的具体情况确定持续督导的内容和重点,督导公司履行有关上市公司规范运作、信守承诺和信息披露等义务,审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所或其他机构提交的其他文件,并按保荐办法要求承担相关持续督导工作。	保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工作制度,针对公司的具体情况确定持续督导的内容和重点,督导公司履行有关上市公司规范运作、信守承诺和信息披露等义务,审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所或其他机构提交的其他文件,并按保荐办法要求承担相关持续督导工作。
2、根据上市规则规定,与公司就持续督导期间的权利义务签订持续督导协议。	保荐机构已与上市公司签署了持续督导协议,协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务。
3、协助和督促上市公司建立相应的内部制度、决策程序及内控机制,以符合法律法规和上市规则的要求,并确保上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员、核心技术人员知晓其在上市规则下的各项义务。	保荐机构已协助和督促上市公司建立相应的内部制度、决策程序及内控机制,以符合法律法规和上市规则的要求,并确保上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员、核心技术人员知晓其在上市规则下的各项义务。
4、持续督促上市公司充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息,并确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。	保荐机构已持续督促上市公司充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息,并确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
5、对上市公司制作信息披露公告文件提供必要的指导和协助,确保其信息披露内容简明易懂,语言浅白平实,具有可理解性。	保荐机构已对上市公司制作信息披露公告文件提供必要的指导和协助,确保其信息披露内容简明易懂,语言浅白平实,具有可理解性。
6、督促上市公司控股股东、实际控制人履行信息披露义务,告知并督促其不得要求或者协助上市公司隐瞒重要信息。	保荐机构已督促上市公司控股股东、实际控制人履行信息披露义务,告知并督促其不得要求或者协助上市公司隐瞒重要信息。
7、上市公司或其控股股东、实际控制人作出承诺的,保荐机构、保荐代表人应当督促其对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露。 保荐机构、保荐代表人应当针对前款规定的承诺披露事项,持续跟进相关主体履行承诺的进展情况,督促相关主体及时、充分履行承诺。 上市公司或其控股股东、实际控制人披露、履	本持续督导期间,上市公司及控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的情况。 上市公司或其控股股东、实际控制人已对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露。

项 目	工作内容
行或者变更承诺事项，不符合法律法规、上市规则以及上海证券交易所其他规定的，保荐机构和保荐代表人应当及时提出督导意见，并督促相关主体进行补正。	
8、督促上市公司积极回报投资者，建立健全并有效执行符合公司发展阶段的现金分红和股份回购制度。	保荐机构已督促上市公司积极回报投资者，建立健全并有效执行符合公司发展阶段的现金分红和股份回购制度。
9、持续关注上市公司运作，对上市公司及其业务有充分了解；通过日常沟通、定期回访、调阅资料、列席股东大会等方式，关注上市公司日常经营和股票交易情况，有效识别并督促上市公司披露重大风险或者重大负面事项，核实上市公司重大风险披露是否真实、准确、完整。	保荐机构已持续关注上市公司运作，对上市公司及其业务有充分了解；通过日常沟通、定期回访、调阅资料、列席股东大会等方式，关注上市公司日常经营和股票交易情况。本持续督导期间，上市公司不存在应披露而未披露的重大风险或者重大负面事项。
10、重点关注上市公司是否存在如下事项： （一）存在重大财务造假嫌疑； （二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益； （三）可能存在重大违规担保； （四）资金往来或者现金流存在重大异常； （五）上交所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项。 出现上述情形的，保荐机构及其保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起 15 日内按规定进行专项现场核查，并在现场核查结束后 15 个工作日内披露现场核查报告。	本持续督导期内，上市公司未出现该等事项。
11、关注上市公司股票交易严重异常波动情况，督促上市公司及时按照上市规则履行信息披露义务。	本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。
12、上市公司日常经营出现下列情形的，保荐机构、保荐代表人应当就相关事项对公司经营的影响以及是否存在其他未披露重大风险发表意见并披露： （一）主要业务停滞或出现可能导致主要业务停滞的重大风险事件； （二）资产被查封、扣押或冻结； （三）未能清偿到期债务； （四）实际控制人、董事长、总经理、财务负责人或核心技术人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施； （五）涉及关联交易、为他人提供担保等重大事项； （六）本所或者保荐机构认为应当发表意见的	本持续督导期间，保荐机构、保荐代表人已就上市公司及相关主体出现的该等事项发表意见并披露，不存在对该等事项应发表意见而未发表的情形。

项 目	工作内容
其他情形。	
<p>13、上市公司业务和技术出现下列情形的，保荐机构、保荐代表人应当就相关事项对公司核心竞争力和日常经营的影响，以及是否存在其他未披露重大风险发表意见并披露：</p> <p>（一）主要原材料供应或者产品销售出现重大不利变化；</p> <p>（二）核心技术人员离职；</p> <p>（三）核心知识产权、特许经营权或者核心技术许可丧失、不能续期或者出现重大纠纷；</p> <p>（四）主要产品研发失败；</p> <p>（五）核心竞争力丧失竞争优势或者市场出现具有明显优势的竞争者；</p> <p>（六）本所或者保荐机构认为应当发表意见的其他情形。</p>	<p>本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。</p>
<p>14、控股股东、实际控制人及其一致行动人出现下列情形的，保荐机构、保荐代表人应当就相关事项对上市公司控制权稳定和日常经营的影响、是否存在侵害上市公司利益的情形以及其他未披露重大风险发表意见并披露：</p> <p>（一）所持上市公司股份被司法冻结；</p> <p>（二）质押上市公司股份比例超过所持股份80%或者被强制平仓的；</p> <p>（三）上交所或者保荐机构认为应当发表意见的其他情形。</p>	<p>本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。</p>
<p>15、督促控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员履行其作出的股份减持承诺，关注前述主体减持公司股份是否合规、对上市公司的影响等情况。</p>	<p>保荐机构已督促控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员履行其作出的股份减持承诺，持续关注前述主体减持公司股份是否合规、对上市公司的影响等情况。</p>
<p>16、持续关注上市公司建立募集资金专户存储制度与执行情况、募集资金使用情况、投资项目的实施等承诺事项，对募集资金存放与使用情况进行现场检查。</p>	<p>本持续督导期间，上市公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已全部销户。</p>
<p>17、保荐机构发表核查意见情况。</p>	<p>本持续督导期间，保荐机构发表核查意见具体情况如下：</p> <p>2024年3月14日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于气派科技股份有限公司向控股子公司增资暨关联交易的核查意见》；</p> <p>2024年4月2日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于气派科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》</p> <p>《海通证券股份有限公司关于气派科技股份</p>

项目	工作内容
	有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告》； 2024 年 4 月 3 日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于气派科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告》； 2024 年 5 月 25 日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于气派科技股份有限公司 2023 年年度报告的事后审核问询函回复之核查意见》； 2024 年 6 月 15 日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于气派科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》。
18、保荐机构发现的问题及整改情况（如有）	本持续督导期间，上市公司存在业绩亏损，保荐机构将根据《保荐办法》等相关规定认真履行持续督导职责，对上市公司持续经营等情况进行持续重点关注。

二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况

海通证券持续督导人员对上市公司 2024 年上半年的信息披露文件进行了事前或事后审阅，包括股东大会会议决议及公告、董事会会议决议及公告、监事会会议决议及公告、募集资金使用和管理的相关报告和其他临时公告等文件，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。

经核查，保荐机构认为，上市公司严格按照证券监督部门的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、重大风险事项

在 2024 年上半年，公司面临的主要风险事项如下：

（一）业绩亏损的风险

报告期内，归属于上市公司股东的净利润为-4,059.57 万元，由于半导体行业回暖，归属于上市公司股东的净利润比上年同期亏损减少 2,883.35 万元，若未来半导体产业持续低迷，公司可能出现持续亏损的情况。

（二）集成电路封装测试领域技术及产品升级迭代风险

近年来，集成电路终端系统产品的多任务、小体积的发展趋势带动了集成电路封装技术朝着高性能、高密度、高散热、晶圆级、薄型化、小型化方向快速发展，相应的 FC、3D、CSP、WLCSP、MCM、SiP、TSV 等先进封装技术应用领域越来越广泛。日月光、安靠、长电科技、华天科技、通富微电等国内外领先企业均已较全面的掌握 FC、3D、CSP、WLCSP、MCM、SiP、TSV、Chiplet 等先进封装技术，而公司产品目前仍以 SOP、SOT 等传统封装形式及 QFN/DFN 为主。如果未来公司的封装技术与工艺不能跟上竞争对手新技术、新工艺的持续升级换代，将可能使得公司市场空间变小；或者公司不能对封装测试产品的应用领域和终端市场进行精准判断，快速识别并响应客户需求的变化，在新产品、新技术研发方面无法保持持续投入，或者正在研发的新产品不能满足客户需要，将难以开拓新的业务市场；进而对公司的经营业绩造成不利影响。

（三）研发技术人员流失风险

公司自成立以来一直从事集成电路封装测试业务，所处行业为资金、资产、技术、管理和人才密集型行业，优秀的研发技术人员是公司赖以生存和发展的基础，是公司获得和保持持续竞争优势的关键。随着集成电路封装测试市场竞争的不断加剧及新的参与者加入，企业之间对人才尤其是优秀研发技术人员的争夺将更加激烈，若公司不能提供更好的发展平台、更有竞争力的薪酬待遇、设立具备较强吸引力的激励考核机制，公司将难以持续引进并留住优秀研发技术人员，公司将可能面临研发技术人员流失的风险；如果出现研发技术人员流失，公司还将面临技术泄密的风险。

（四）毛利率波动风险

公司主要从事集成电路封装测试业务，经营业绩会随着终端产品市场的波动而变化；同时，集成电路封装测试行业竞争激烈，价格相对透明，相应的封装测试企业整体毛利率水平不高。未来若终端产品市场出现较大波动，或者随着市场竞争的加剧、竞争者的数量增多及技术服务的升级导致公司调整产品及服务的定位、降低产品及服务的价格，公司产品毛利率水平存在较大幅度波动的风险，从而对公司经营业绩和盈利能力产生不利影响。

（五）生产效率下降风险

随着公司生产规模的不断扩大、工艺流程的日益复杂，如果集成电路行业持续处于低迷的市场行情，公司未来不能在管理方式上及时创新，生产人员技术水平及熟练程度无法保持或者持续提升，公司将会面临生产效率下降的风险。生产效率下滑将导致公司生产规模无法保持或持续扩大，不仅会使产品交期延长、竞争力削弱及客户流失，同时还会使公司无法保持在成本控制方面的优势，将会对公司经营业绩产生不利影响。

（六）原材料价格波动风险

公司主要原材料包括引线框架、塑封树脂、丝材（金丝、银线、铜线、合金线、铝线）和装片胶。公司原材料价格受市场供求变化、宏观经济形势波动等因素的影响，若未来公司原材料价格出现大幅波动，而公司产品售价不能及时调整，将给公司的盈利能力造成不利影响。

（七）产能消化风险

随着公司募集资金项目的逐步建成和自有资金扩产的逐步实施，将有效提升公司半导体封装测试产能，使公司生产和交付能力得到进一步的提升。当前半导体行业出现了周期性波动，行业景气度下行，如果公司下游市场需求不及预期、市场竞争加剧或公司市场开拓受阻，将可能导致部分生产设备闲置、人员富余，使得公司产能利用率不足、产能消化存在风险，从而无法充分利用全部生产能力而增加产品单位成本费用负担，将对公司未来的经营状况带来不利影响。

（八）存货积压和呆滞风险

公司原材料的交期一般 1-2 个月，而公司主要客户要求的交货周期较短，一般为 15 到 30 天。为快速响应客户的订单需求，公司需要根据订单、客户需求预测以及市场情况等进行原材料采购。若客户需求预测发生调整，市场情况发生变化，公司采购的原材料不能及时通过有效的销售订单投入生产，将导致公司的原材料产生积压或者呆滞的风险，导致占用公司资金及产生存货跌价损失的风险，对公司的业绩水平产生不利影响。

（九）有息负债风险

截止 2024 年 6 月 30 日，公司有息负债余额 43,255.65 万元，其中短期借款金额为 13,192.00 万元，一年以内到期的长期借款金额为 2,176.00 万元，一年以内到期的长期应付款金额为 1,555.36 万元，其他应付款一个人借款金额为 4,300.00 万元，公司有息负债余额较大。若未来银行信贷政策收紧或公司经营活动现金流得不到改善，可能造成公司流动资金紧张，公司有息负债偿付存在一定压力，对公司经营带来不利影响。

（十）新增折旧降低公司盈利能力的风险

公司募投项目和自有资金扩产建成后分步达产，公司固定资产和无形资产规模将进一步扩大，固定资产折旧和无形资产摊销将相应增加，由于实现预期效益需要一定时间，新增的折旧与摊销会导致公司的毛利率、每股收益、净资产收益率等指标出现一定幅度的下降，短期内对净利润增长构成不利影响。如果宏观政策变化、市场变化等具有不确定性，项目投产后可能会出现短期产能消化困难，无法实现预期收益的风险，可能对公司盈利能力造成一定程度的不利影响。

四、重大违规事项

2024 年上半年，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2024 上半年度，公司主要财务数据及指标如下所示：

（一）主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2024年1-6月	2023年1-6月	同比增减
营业收入	313,103,782.50	247,304,265.52	26.61%
归属于上市公司股东的净利润	-40,595,709.81	-69,429,249.77	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-46,833,806.80	-83,722,533.09	不适用
经营活动产生的现金流量净额	37,452,358.29	-1,097,665.10	不适用
主要会计数据	2024年1-6月	上年度末	2024年6月末比上年度末增减
归属于上市公司股	709,685,728.67	745,300,254.67	-4.78%

东的净资产			
总资产	1,915,994,584.35	1,865,430,086.08	2.71%

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年1-6月	2022年1-6月	同比增减
基本每股收益(元/股)	-0.38	-0.66	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.38	-0.66	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.44	-0.79	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-5.58	-8.15	增加2.57个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-6.44	-9.83	增加3.39个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	8.11	9.18	减少1.07个百分点

报告期内，公司营业收入较上年同期增加 6,579.95 万元，增长 26.61%，归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益的净利润亏损程度均同比有所收窄，主要原因系随着市场行情回暖，销售订单有所增加，产能利用率提升。

六、核心竞争力的变化情况

(一) 核心竞争力分析

1、技术优势

集成电路封装测试属于技术密集型行业，行业创新主要体现为生产工艺的创新，技术水平主要体现为产品封装加工的工艺水平。气派科技通过多年的技术研发积累与沉淀，现已形成了 5G MIMO 基站 GaN 微波射频功放塑封封装技术、高密度大矩阵集成电路封装技术、小型化有引脚自主设计的封装方案、封装结构定制化设计技术、产品性能提升设计技术、精益生产线优化设计技术、MEMS 封装技术、大功逐碳化硅塑封封装技术、基干铜夹互联的大功率硅芯片封装技术等核心技术，推出了自主定义的 CDFN/CQFN、CPC 和 Qipai 封装系列产品，对贴片系列产品予以了优化升级等，并已申请了发明专利，公司还掌握了 Flip-Chip、MEMS 等一流的封装技术并成功量产。

2、人才优势

气派科技的多数高级管理人员及部分核心技术人员拥有多年的集成电路技术研发或管理经验，具备国际领先企业的行业视野或国内一流企业的从业经验，是一支经验丰富、结构合理、优势互补的核心团队，为持续提升公司核心竞争力、设计新产品、开发新工艺提供强有力的人力资源支持。

公司不仅在研发人员及管理团队中具备人才优势，也将人才优势进一步推广到生产一线，为近年来公司精益生产线优化设计技术的深层次应用奠定了人力资源基础。公司持续开展六西格玛等培训，建立了“新生力”“后备经理人”培养体系等，公司具备完整人才梯队和人才培养体系。

3、生产组织与质量管理优势

集成电路封装涉及的产品种类繁多，目前公司的主要封装产品包括 MEMS、FC、Qipai、CPC、SOP、SOT、LQFP、QFN/DFN、CDFN/CQFN、TO、DIP、PDFN 等系列。相对齐全的产品线为公司满足客户多元化的产品需求和建立市场优势发挥了重要作用。但同时，不同的产品类型往往需要不同生产工艺、生产设备、供应商体系、技术及管理队伍相匹配，这对封装企业的生产组织能力和质量管理提出了严格的要求。

公司致力于持续提升生产管理水平和强化质量管理，培养了经验丰富的研发技术人员和一大批生产管理人才。基于丰富的生产经验和成熟的技术工艺，公司采用柔性化的生产模式，能根据客户的订单要求，灵活地分配生产计划和产品组合，迅速地调试和组合生产线，实现高效率、多批次、小批量的生产，有效地增强了市场反应能力。公司建立了严格的质量管理体系，完善了工作规范和质量、工艺控制制度，并通过了 ISO9001:2015 质量管理体系、IATF14969:2016 汽车行业质量管理体系、ISO14001:2015 环境管理体系和 ISO22301 业务连续性管理体系认证。

4、地域优势

公司客户主要为集成电路芯片设计企业，其对交货时间要求严格，交货时间短和便利的地理位置可为集成电路芯片设计企业减少库存，节约运输时间和资金

成本,及时应对来自客户的随机性和突发性需求,方便企业与客户的交流和反馈,增强其竞争力。

公司地处粤港澳大湾区,电子元器件配套市场的迅速崛起以及半导体设计行业的蓬勃发展为气派科技提供了快速发展的沃土。公司充分发挥地域优势进行客户开拓,通过上门接送货物等服务方式节约运输时间、缩短交货期和降低物流成本,加深与客户的交流,销售服务利于得到客户认可,提高公司市场占有率。

5、规模优势

芯片设计公司选择长期合作伙伴时,着重考虑封装测试厂商是否具备足够的产能规模,是否具备大批量、高品质供货的能力。为构建公司在国内封装测试行业的规模优势,公司在东莞投资完成了自有厂房的建设,为持续的产能的扩充以及技术改造提供了物理条件。

公司现已发展成为华南地区规模最大的内资封装测试企业之一,已形成了自身的规模优势。同时,公司仍在进行持续的资本性支出,不仅提升了公司提升,继续利用规模优势来巩固和提高公司在行业内的竞争地位。

6、智能化生产优势

近年来,公司秉承打造智能化工厂建设为目标,按照数字工厂总体设计和布局,先后从网络安全、系统架构、数据分析等多方向规划、持续建设,陆续导入制造执行系统(MES)、先进排产计划系统(APS)、设备控制自动化系统(EAP)等系统,并与企业资源计划管理系统(ERP)集成,实时数据平台与生产管理系统实现互通集成。从而建设成制造资源数字化、生产过程数字化、现场运行数字化、质量管控数字化、物料管控数字化的智能工厂,生产数据通过工况在线感知、智能决策与控制、设备自律执行大闭环过程,不断提升设备性能、增强自适应能力。实现研发、生产、运营的全流程数字化管理,最优化分派生产订单和工作任务,全流程追溯生产过程中的物料、治具条码等,有效提高制造资源利用率、人均产能、产品质量良率,有效降低生产成本。2022年,公司全资子公司广东气派荣获“东莞市智能制造示范项目”“东莞市智能工厂”称号,2023年,广东气派“精益生产管理”和“质量精准追溯”两个场景入选“工信部智能制造优秀场景”名单。

（二）核心竞争力的变化情况

2024 年上半年，气派科技的核心竞争力未发生重大不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

2024 年上半年，公司的研发支出情况如下：

单位：元

	本期数	上年同期数	变化幅度 (%)
费用化研发投入	25,387,287.46	22,692,514.73	11.88
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	25,387,287.46	22,692,514.73	11.88
研发投入总额占营业收入比例 (%)	8.11	9.18	减少 1.07 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	-	-	-

报告期内，公司共申请了 24 项专利，其中发明专利 6 项；获得了 13 项专利授权，其中发明专利 7 项，具体情况如下：

	本期新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	6	7	97	44
实用新型专利	18	6	253	204
外观设计专利	0	0	88	73
软件著作权	0	0	1	1
合计	24	13	439	322

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况是否合规

截至报告期初，公司 IPO 募集资金已全部使用完毕，所有募集资金专户均已注销完毕。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

2024年上半年，公司控股股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员持股不存在变动，不存在质押、冻结或减持情况。

十一、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告或应当发表意见的其他事项

经核查，截至本持续督导跟踪报告出具之日，上市公司不存在按照《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告或应当发表意见的其他事项。

十二、其他说明

本报告不构成对上市公司的任何投资建议，保荐机构提醒投资者认真阅读上市公司半年度报告等信息披露文件。

（以下无正文）

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于气派科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名:



薛 阳



徐 扬

